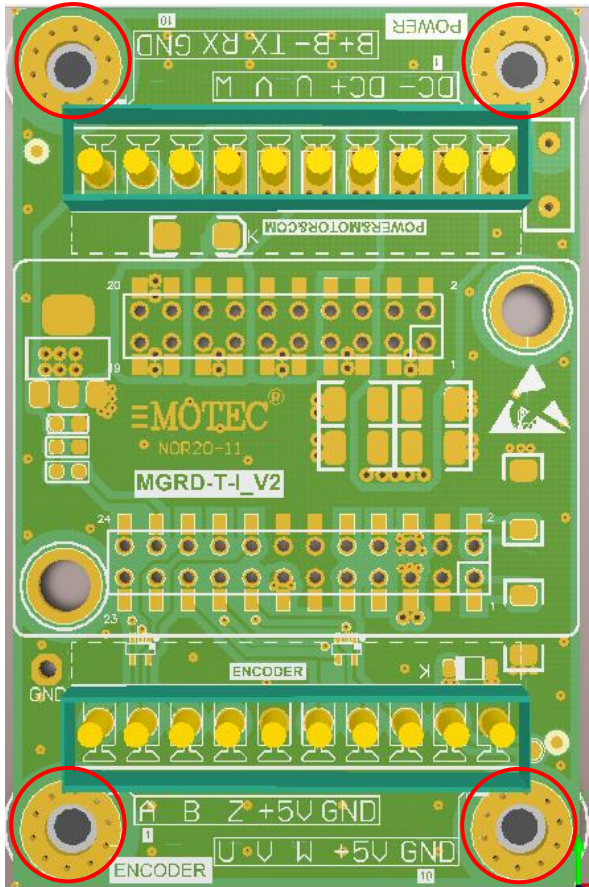


|                |              |                      |          |                     |          |           |                  |
|----------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------|
| PCB 焊接<br>工艺要求 | 产品名称<br>直流伺服 | 产品型号<br>MGRD-T1-I_V2 | 工序<br>焊接 | 文件编号<br>QM033201103 | 版本<br>V2 | 页数<br>1/1 | 制订时间<br>20201103 |
|----------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|----------|-----------|------------------|

## 焊接基本要求

1) 下图红圈标识 LH1~LH4 底层贴片螺母焊接后，其焊锡填满过孔，但不能超出顶层平面；



- 2) 'LH1, LH3 元件为' SMTWE3340MTJ (中通不带螺纹)，LH2, LH4 元件为 SMTS03040MTS (带螺纹)；
- 3) 注意 Z1, Z2 元件的焊接，不接受空焊；
- 4) 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
- 5) 所有极性元件，严禁方向反；
- 6) 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
- 7) 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
- 8) 手工操作要做防静电处理；
- 9) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
- 10) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件；

|    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|
| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |